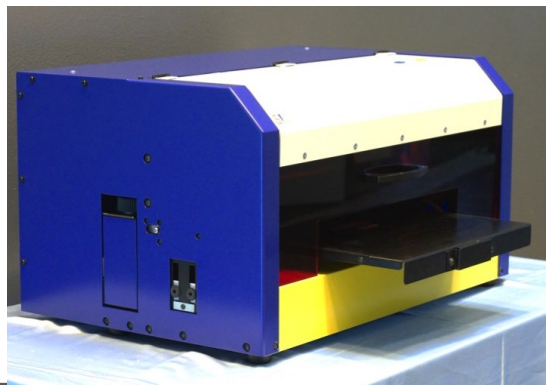


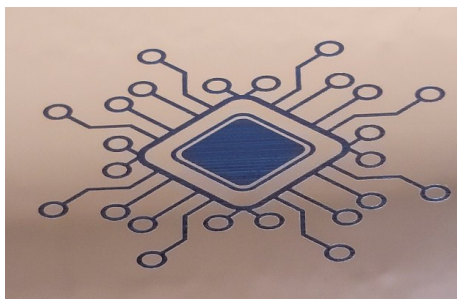
スマートプリンタ

UV硬化型樹脂の印刷及び硬化工程を装置内で完結！

- ・最小線幅 約100 μm
- ・印刷解像度 1440×1440dpi相当
- ・A4サイズ 約240秒で高速印刷
- ・小ロット、多品種生産向けで使用
- ・インクの補充は1分で完了



印刷事例



電気回路形成



スイッチ部品の接点部絶縁



アンテナパターン

用途例

◆ガラス基板・光学部品への遮光マスク印刷

光学部品やガラス基板上に遮光用マスクを印刷し、不要光の遮断や光学特性の制御を実現。

◆電気部品への絶縁パターン印刷

電気部品表面に絶縁パターンを形成することで、部品間のショート防止や電氣的分離を達成。

◆銅張積層基板、銅張フィルムへのエッチングマスク印刷

印刷したマスク(レジスト)上にエッチング処理を施すことで、回路基板やアンテナパターンを高精度に形成可能。

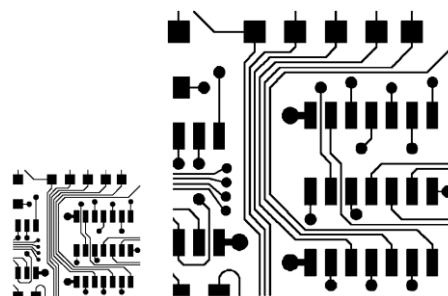
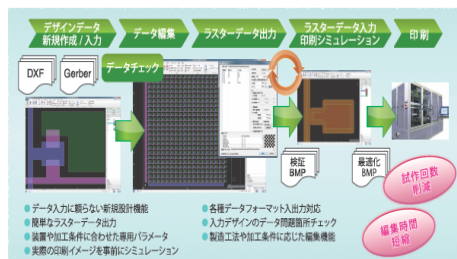
仕様

仕様	スマートプリンタ SMP-3021
印刷方式	ピエゾ駆動型インクジェット方式（最小線幅100 μm ）※条件により異なる場合があります。）
印刷データ形式	二値化ビットマップ形式
搭載可能メディア寸法	300mm (W) × 210mm (D) × 1.0～1.6mm (H) *別売スペーサーにより厚み30mm まで対応可能
印刷速度	100mm/sec、250mm/sec（ソフトウェアで選択）
装置サイズ	約600mm (W) × 350mm (D) × 350mm (H)
本体電源及び消費電力	AC100～250V 消費電力100W以下
オプション	DMF Inkjet（印刷データ作成ソフト）、吸着ステージ

印刷プロセス

Step1. 印刷データを作成 (二値化BMP形式)

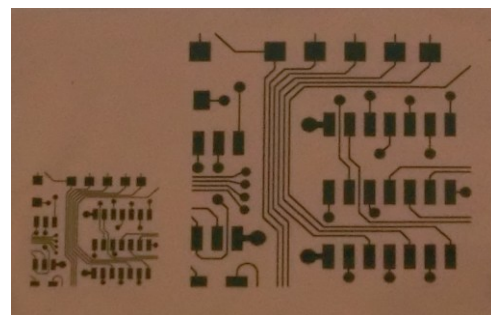
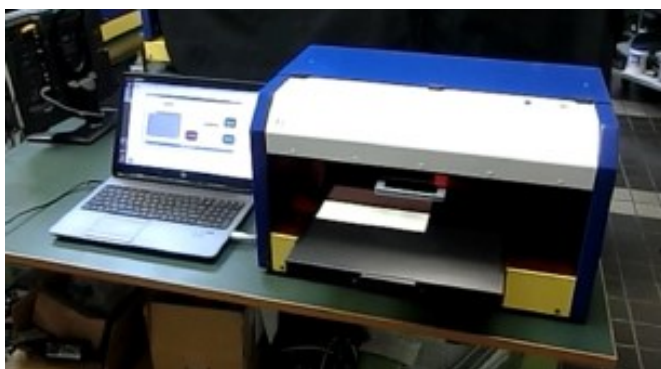
編集ソフト(DFM Inkjetなど)を用いて
DXF、Gerber、PDFデータをBMPデータに変換。



二値化BMPデータ

Step2. スマートプリンタで印刷

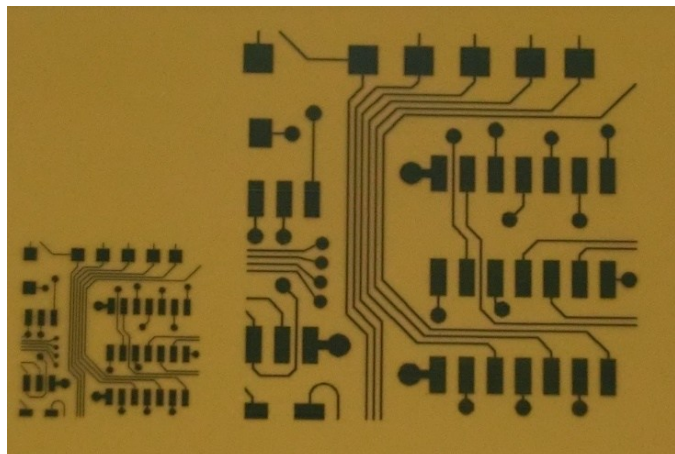
PCから装置を操作
基板をセットし、印刷ボタンを押すだけ。



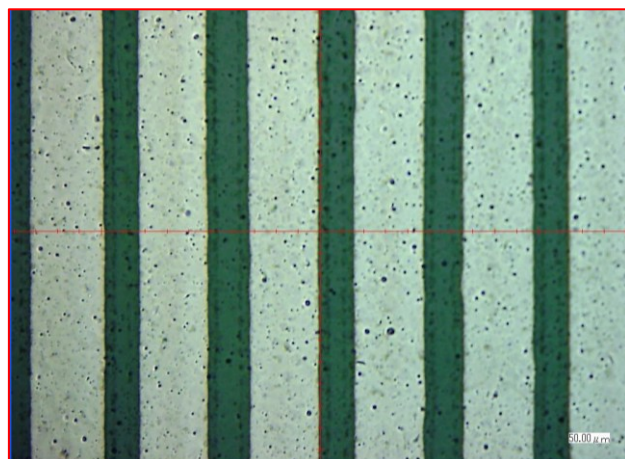
印刷後

Step3. エッチング処理

レジストマスク形成
(エッチングマスク形成)



Step4. レジスト材剥離処理



事例
基板: 銅張りPIフィルム